



发布日期: 2013 年 2 月 20 日

生效日期: 2013 年 2 月 20 日

文件修订状态

修订日期	文件版本	修订页		修订内容	修订部门	修订者
		页次	版本			
2010 年 2 月 24 日	A/1	全部	A/0	1. 生产制造部变更为生产管理部, 总经理办公室和设备管理部取消, 相关职能变更到人力资源部和生产管理部。 2. 附件一按 SONY SS-00259 标准第八版要求和新增 14 种 SVHC 更新《环境管理物质控制标准》。	安全保卫部	马凤新
2010 年 12 月 27 日	A/2	全部	A/1	附件一《环境管理物质控制承诺书》中新增: 1. 第三批 8 种 SVHC, 第四批 8 种 SVHC, 更新《环境管理物质控制标准》 2. 第 4 条环保标识要求。	安全保卫部	马凤新
2011 年 11 月 24 日	A/3	全部	A/2	附件一《环境管理物质控制承诺书》中新增: SONY SS-00259 标准第十版新增物质和第五批 7 种 SVHC, 更新《环境	安全保卫部	马凤新



				管理物质控制标准》		
2012 年 2 月 20 日	A/4	全部	A/3	<p>1. 生产管理部取消, 相关职能变更到封装管理部和设备管理部。</p> <p>2. 增加 3.8. 生产部门的职责。</p> <p>3. 附件一《环境管理物质控制承诺书》中新增: 第六批 20 种 SVHC, 更新《环境管理物质控制标准》, 更新了《有害物质调查表》。</p>	安全保卫部	马凤新
2012 年 6 月 26 日	A/5	全部	A/4	<p>附件一《环境管理物质控制承诺书》表 2: 环境管理物质控制标准中</p> <p>1. 铅以及铅化合物 (Pb) 改为$\leq 90\text{ppm}$</p> <p>2. 新增: SONY SS-00259 标准第十一版新增物质和第七批 13 种 SVHC, 更新《环境管理物质控制标准》, 更新了《有害物质调查表》。</p>	安全保卫部	马凤新
2012 年 12 月 18 日	A/6	全部	A/5	<p>1. 修订 3. 职责中相关部门的 HSF 管理职责。</p> <p>2. 修订 5.2.4. HS 环境</p>	安全保卫部	马凤新



				<p>管理物质清单和附件一 《环境管理物质控制承诺书》表 2: 环境管理物质控制标准: 铅以及铅化合物 (Pb) 改为$\leq 90\text{ppm}$(晶体管引线管脚的锡), $\leq 50\text{ppm}$ (其他); 包装材料中的镉、铅、汞、六价铬 $< 50\text{ppm}$ & $\text{Cd} \leq 5\text{ppm}$</p>		
2013 年 2 月 18 日	A/7	全部	A/6	<p>1. 附件一《环境管理物质控制承诺书》中原 (2002/95/EC) RoHS 指令变更为 (2011/65/EU) RoHS2.0 2. 新增第八批 54 种 SVHC, 更新《环境管理物质控制标准》和《有害物质调查表》。</p>	安全保卫部	马凤新
2013 年 7 月 10 日	A/8	全部	A/7	<p>附件一《环境管理物质控制承诺书》表 2: 环境管理物质控制标准中新增: SONY SS-00259 标准第十二版新增物质和第九批 6 种 SVHC, 更新《环境管理物质控制</p>	安全保卫部	马凤新



华微电子
SINO-MICROELECTRONICS

有害物质控制管理程序

编号: Q/IGD.H4101

版本号: A/9

机密等级: C级

第 5 页共 42 页

拟制

	日期	部门	职位	姓名	备注
1	2009年6月25日	安全保卫部	EHS体系 管理员	马凤新	
2					

会签

	日期	部门	职位	姓名	备注
1	2013年7月15日	董事会秘书处	主任	聂嘉宏	
2	2013年7月15日	MOS产品事业部	经理	李彦庆	
3	2013年7月15日	销售业务部	经理	李斌晖	
4	2013年7月15日	运营中心	经理	鞠晓峰	
5	2013年7月15日	双极产品事业部	经理	田洪光	
6	2013年7月15日	整流产品事业部	副经理	蒋和平	
7	2013年7月15日	质量管理部	副经理	于雄飞	
8	2013年7月15日	材料部	经理	杨克鑫	
9	2013年7月16日	安全保卫部	经理	赵连奎	
10	2013年7月16日	供应链管理中心	经理	于胜东	
11	2013年7月16日	技术工程部	副经理	黄光波	

批准

	日期	部门	职位	姓名	备注
1	2013年7月17日	人力资源部	总经理	赵东军	



1. 目的

在生产制造全过程（包括采购、生产、销售、相关方活动），禁止或限制使用某些化学物质，以降低产品的环境负荷，减少产品生产过程中的环境污染，保护生态环境，满足客户的环保要求。

2. 范围

吉林华微电子股份有限公司原材料和备品备件采购、外协加工、生产、销售全过程。

3. 职责

3.1. 安全保卫部

- 3.1.1. 负责 HSPM 体系建设、审查；
- 3.1.2. 负责组织与外协厂家及原材料厂家签订 HS 控制协议；
- 3.1.3. 负责对相关方进行环境管理物质控制的审核和评价；
- 3.1.4. 负责环境管理物质控制相关法律、法规的识别，并进行公司内部管理文件的转化；
- 3.1.5. 负责确认相关方有害物质的第三方检测报告。

3.2. 技术工程部

- 3.2.1. 负责客户需求的 HSF 产品生产工艺设计、方案制定及变更；
- 3.2.2. 负责 HSF 控制相关标准的识别，并依此进行环境管理物质含量标准的制定；
- 3.2.3. 负责审核 HS 控制协议标准的相关技术和标准条款；
- 3.2.4. 负责掌握我公司产品中含有的 HS 种类或含量，并按照客户要求提供材料分析表；

3.3. 供应链管理中心

- 3.3.1. 负责 HSF 材料采购；
- 3.3.2. 负责组织外协封装厂按照 HS 标准进行生产，监督外协生产过程。
- 3.3.3. 负责向供应商和外协厂商传递 HS 控制信息，收集有害物质管理要求的相关资料，并存档。
- 3.3.4. 负责收集并更新合格供应商的有害物质第三方检测报告（如 SGS 报告等），并上传到 OA 系统。
- 3.3.5. 按照客户要求提供外协产品材料分析表，及时更新外协产品及原材料的有害物质第三方检测报告，并上传到 OA 系统。

3.4. 质量管理部



- 3.4.1. 负责原材料及备品备件、成品及半成品的 HS 含量、相关包装标识的检验、跟踪；对于客户在环保产品包装标识上的特殊要求负责进行粘贴、检验、跟踪。
- 3.4.2. 负责组织 HS 控制体系建立的监督；
- 3.4.3. 负责生产现场过程（包括外协厂家）HS 的控制管理。
- 3.4.4. 负责有关 HS 客户要求的信息反馈及收集。
- 3.5. 运营中心
 - 3.5.1. 负责组织制定 HSF 生产计划，不符合 HSF 要求的产品库存销售计划；
 - 3.5.2. 运营中心负责统计不符合 HSF 的产品，并区分、隔离存放，做好相应标识；
 - 3.5.3. 运营中心库房及销售业务员对有 HS 要求的客户进行严格的发货控制；
 - 3.5.4. 负责客户 HSF 要求的收集、整理、汇总，并组织相关部门进行评审。
- 3.6. 法律事务部门
 - 3.6.1. 从法律角度对 HS 协议进行审核。
- 3.7. 生产部门
 - 3.7.1. 负责按照生产计划生产 HSF 产品，严格控制生产过程，避免造成 HS 有害物质污染。

4. 定义

无

5. 内容

- 5.1. 吉林华微电子股份有限公司对 HS 的控制实施全过程管理，包括原材料和备品备件采购、外协加工、设计、生产、销售全过程；
- 5.2. 吉林华微电子股份有限公司对 HS 的管理按照三个级别进行控制：
 - 5.2.1. 一级管控：

参见《HS 环境管理物质清单》具体的控制方法：

 - 5.2.1.1. 在指定用途范围内，零部件和材料中禁止含有；
 - 5.2.1.2. 在生产过程中控制因设备或辅助材料含有此类有害物质，而对产品造成污染；
 - 5.2.1.3. 提供有效的检测报告，并实施过程检测；
 - 5.2.1.4. 供应商承诺；
 - 5.2.1.5. 实施有效的控制措施；
 - 5.2.2. 二级管控：

- 5.2.2.1. 在指定用途范围内，主要原材料（组成原材料）中禁止含有；
- 5.2.2.2. 供应商承诺；
- 5.2.3. 三级管控：
 - 5.2.3.1. 登记备案。
- 5.2.4. HS 控制标准

我公司环境管理物质控制按照 SONY SS-00259 标准进行控制。参照《HS 物质清单及其检测标准》，制定如下清单：

HS 环境管理物质清单

序号	有害物质名称	使用对象	所对应之零件	管理级别	管制标准	状态确认
1	镉及其化合物	晶体管封装材料、包装材料、表面处理材料	电子元器件；塑封料； 脱模剂；清膜剂；粘片焊料；导电胶；焊锡； 助焊剂；引线框架；聚酰亚胺；金丝；铜丝； 铝丝；电镀材料；包装材料；	1 级	不超过 5 ppm	无使用
2	铅以及铅化合物	晶体管的锡均质材料	引线管脚镀层的锡	1 级	不超过 90 ppm	纯锡条（球）中含有，但不超标
		晶体管封装材料、包装材料、表面处理材料	电子元器件；塑封料； 脱模剂；清膜剂；粘片焊料；助焊剂；引线框架； 聚酰亚胺；金丝；铜丝；铝丝；电镀材料； 包装材料；		不超过 50 ppm	
3	汞以及汞化合物	晶体管封装材料、包装材料、表面处理材料	电子元器件；塑封料； 脱模剂；清膜剂；粘片焊料；助焊剂；引线框架； 聚酰亚胺；金丝；铜丝；铝丝；电镀材料； 包装材料；	1 级	禁用	无使用
4	六价铬化合物	塑料(包括橡胶)、涂料、墨水	电子元器件；塑封料； 脱模剂；清膜剂；粘片焊料；助焊剂；引线框架； 聚酰亚胺；金丝；	1 级	禁用	无使用



			铜丝; 铝丝; 电镀材料; 包装材料;			
5	聚溴联苯 (PBB)	用于塑料的 阻燃剂等所 有用途	塑封料	1级	禁用	无使用
6	聚溴联苯醚 (PBDE)	用于塑料的 阻燃剂等所 有用途	塑封料	1级	禁用	无使用
7	PFOS、PFOA	电镀中的添 加剂,油类	电镀 油类等辅材	1级	<1000ppm	无使用
8	镉及其化合物	塑料中的阻 燃剂	环氧塑封料	1级	<900ppm	无卤产品(塑封 料)中不含有
				3级	---	普通塑封料中 含有此物质含 量大约为 0.5%~2%
9	卤素 (F,Cl,Br,I)	塑料中的阻 燃剂	环氧塑封料,导电胶	1级	(无卤产品中) Cl<700ppm Br<700ppm +Br<1000pp m。	无卤产品(塑封 料)中不含有
				3级	---	普通塑封料中 含有
10	包装材料中的 镉、铅、汞、 六价铬		包装材料	1级	总和<50ppm Cd≤5ppm	包装材料
11	聚氯乙烯 (PVC)及其 混合物		塑封料	3级	---	料管类包材
12	多环芳烃类 (PAHs)		塑封料	2级	禁用	无使用
13	双酚 A		塑封料	2级	禁用	无使用
14	特定邻苯二甲 酸盐(DEHP、 DBP、BBP、 DINP、DIDP、 DNOP)		塑封料	2级	禁用	无使用
15	REACH 第 1 批 15 种		塑封料、芯片	2级	<1000ppm	无使用



	SVHC					
16	REACH 第 2 批 15 种 SVHC		塑封料、芯片	2 级	<1000ppm	无使用
17	REACH 第 3 批 8 种 SVHC		塑封料、引线管脚、芯片	2 级	<1000ppm	无使用
18	REACH 第 4 批 8 种 SVHC		引线管脚、芯片	2 级	<1000ppm	无使用
19	REACH 第 5 批 7 种 SVHC		塑封料、引线管脚	2 级	<1000ppm	无使用
20	REACH 第 6 批 20 种 SVHC		塑封料、引线管脚、芯片	2 级	<1000ppm	无使用
21	REACH 第 7 批 13 种 SVHC		塑封料、引线管脚、芯片	2 级	<1000ppm	无使用
22	REACH 第 8 批 54 种 SVHC		塑封料、引线管脚、芯片	2 级	<1000ppm	无使用
23	REACH 第 9 批 6 种 SVHC		引线管脚、芯片	2 级	<1000ppm	无使用
24	REACH 第 10 批 7 种 SVHC		引线管脚、芯片	2 级	<1000ppm	无使用

注: * 当有环境管理物质管制标准或管理等级变更时, 要立即对变更的环境管理物质状态进行重新调查与评审, 并把状态调查内容填入此表中。

* 豁免要求参照欧盟第 2011 / 65 / EU 指令。

5.3. 供应商和外协厂商的控制

5.3.1. 组成我公司产品的主要原材料, 必须符合我公司 HS 控制标准 (包括一级和二级管控物质)。包括以下:

塑封料、脱模剂、清膜剂、粘片焊料、沾锡用锡条、油墨、助焊剂、清洗剂、硅单晶片、引线框架、键合丝、内涂料、包装 (包括: 泡沫、塑料袋、纸盒 (包括纸盒油墨)、条管、编带、胶带、捆绑带、标签、胶垫、缓冲材料、用于搬运的部分)。

5.3.2. 禁止采购含有 HS 的零部件或材料, 禁止在外协加工过程中引入 HS。

5.3.3. HSF 合格供应商和外协厂商的认证:



- 5.3.3.1. 在开发新的材料供应商和外协厂商时，应按《供应商管理程序》和《封装外包管理程序》进行。供应商和外协厂商送样时需附以下资料：
 - 5.3.3.2. SGS（通标标准服务技术有限公司）或其他指定第三方公认检测机构的最新的《检测报告》，《检测报告》的有效期为一年。
 - 5.3.3.3. 《环境管理物质控制承诺书》、《零/部件或原材料成份展开表》、《有害物质调查表》。
 - 5.3.3.4. 《MSDS 物质安全数据表》（化学危险品、塑封料、粘片焊料等供货商提供）。
 - 5.3.3.5. 符合 ROHS 要求的样品。
 - 5.3.3.6. 其他所必须材料（供应商管理程序所要求的）。
- 5.3.4. 认证合格后，应建立合格供应商和合格外协加工方名录。
- 5.3.5. 要求供应商、产品外协厂家等相关方，建立环境管理组织机构、管理体系和制度，并对我公司进行 HS 控制保证承诺；
- 5.3.6. 要求供应商或外协加工厂商，应提供 HS 含有清单，包括其含有量、含有部位、含有用途等相关信息；
- 5.3.7. 供应商应每年进行一次 HS 检测，检测的材料和零部件，应从贵公司的出货成品中抽出（必须为同工艺、同材料、同型号的产品），送检机构应为 SGS（通标标准服务技术有限公司）或其他指定第三方公认检测机构，并将检测报告提供给我公司。
- 5.3.8. 供应商和外协厂商的生产工艺或原材料发生变更时，要及时通知我公司。
- 5.4. 当发生以下情况时，应立即对供应商、外协厂商重新认证。
 - 5.4.1. 产品原材料更换（包括更换厂家、种类、型号）；
 - 5.4.2. 设备更换；
 - 5.4.3. 工艺调整；
 - 5.4.4. 出现环境事故；
 - 5.4.5. 被第二、三方投诉时；
- 5.5. 生产过程中 HS 控制
 - 5.5.1. 生产过程中影响产品 HS 的过程，包括芯片包装、芯片运输、粘片、后处理、沾锡、清洗、测试、压线、包封、包装、打印、库存等过程。
 - 5.5.2. 根据现场生产过程情况，按照《HSPM 风险评估管理程序》对影响 HS 的因素进行辨识和识别，并制定相应的控制措施。
 - 5.5.3. 生产 HSF 产品的人员均需要经过培训，符合生产环保订单的操作技能和环保意识。



- 5.5.4. 对用于生产使用的工夹器具, 设备(设备与产品接触的部分、无铅波峰焊, 电批, 烙铁等)均需要对其进行环保控制。
 - 5.5.5. 在生产过程中不得随意更换原材料, 辅助材料, 工夹器具或设备, 也不得随意添加有机溶剂等杂质。
 - 5.5.6. 生产单位严格按标准的操作程序和设定的条件进行操作, 定期点检及保养。
 - 5.5.7. 确保主要原材料、设备、工夹器具、辅助材料及辅助化学溶剂, 如硅油, 脱模剂, 稀释剂, 助焊剂, 信那水, 油漆, 油墨等在制程中不受到污染, 所有设备、工夹器具在使用前都必须被处理和确认, 避免含有环境管理物质而造成污染。
 - 5.5.8. 生产时需实行严格的批次管理, 具体要求按《标识和可追溯性管理程序》执行。批次管理确保有效的追溯性, 包括成品追溯至零件, 原材料, 库存品, 供货商, 生产线别, 生产人员, 生产的设备等。
 - 5.5.9. 对于生产现场存在非环保产品时, 必须设置专用的设备、工夹器具和存储区域, 做好环保产品和非环保产品的隔离。包括使用设备的隔离、存储地点的隔离、处理工艺的隔离。如果做不到设备和工夹器具的隔离, 必须在切换前进行清洗, 保证不被污染。
 - 5.5.10. 要定期对生产线或库存产品进行检测, 具体控制方法见《产品监视和测量管理程序》。
- 5.6. HS 协议或承诺
- 5.6.1. 客户对我公司的 HSF 要求, 经市场部反馈我公司后, 由运营中心填写《技术、质量、HSF、EHS 协议》, 依次传递相关部门。
 - 5.6.2. 签订 HS 协议或承诺应在两天之内会签结束, 如市场部要求时间紧迫, 在会签表上标明时间, 并安排人全程进行跟踪, 必要时召集相关部门进行会议会签。
 - 5.6.3. 对于符合我公司要求的合格原材料供应商、外协加工厂商, 应要求其出具符合我公司 HS 控制标准的协议或承诺书。
- 5.6.4. 客户 HS 承诺书异议的处理
- 5.6.4.1. 在承诺书或协议的签订过程中, 如出现异议或发现问题, 应由相关部门提出建议或应对措施。安全保卫部负责提出 HS 方面法律、法规条款的沟通建议, 技术工程部负责产品 HS 含量、成份方面的沟通建议, 法律事务部门负责提出协议法律符合性的沟通建议, 质量管理部负责提出我公司产品含量超标问题的沟通建议, 并以文字的形式传给相应的客户。
 - 5.6.4.2. 如果客户提出我公司 HS 清单以外的物质时, 被视为特殊 HSF 要求, 对于特殊 HSF 要求, 应进行评审, 且由技术工程部确认我公司产品是否含有此



类物质。

- 5.6.4.3. 技术工程部根据市场部反馈的信息,对于判定我公司产品中是否含有特殊 HSF 的物质。如不能判定,应拿出解决方案,或者对我公司产品进行 SGS 检测;或者对供应商进行调查。
- 5.6.5. 对于重要客户提出的 HS 要求,如信函、电话沟通仍不能解决问题,可以由市场部业务员组织相关技术、管理人员进行现场沟通。
- 5.6.6. 如沟通仍不能解决问题,组织技术工程部、运营中心、封装管理部、质量管理部、安保部、采购中心等相关部进行会议评审,并做好会议记录。
- 5.6.7. 在评审结束后,组织部门将评审内容和相关控制措施,要以书面的形式,反馈给相关责任部门,由责任部门制定控制解决方案。
- 5.7. HS 不符合的处理:
 - 5.7.1. 供应商原材料及外协产品不合格:

质量管理部对原材料及外协产品进行检测,如发现不合格,将通过书面的形式告之供应商或外协厂家。同时,将此批货物或产品送第三方检测机构进行检测,如确认为 HS 不合格品,则对该批次原材料或产品按照 5.9 条款要求处理。
 - 5.7.2. 生产过程中发现不合格品时,应在生产现场停止此批产品的传递,并放置在 HSF 不良区域内,且书面联络相关部门。
 - 5.7.3. 客户 HS 问题反馈,参照《客户投诉管理程序》。
 - 5.7.3.1. 当发现 HS 异常时,包括原材料异常、生产工艺过程异常、产品异常,应立即逐级汇报给环境管理物质负责人,并以反馈单的形式通报给相关责任人,按照《不合格品管理程序》进行处理。
 - 5.7.3.2. 当客户提出 HS 抱怨时,应由市场部将该产品的型号、批次等信息传递回我公司,由质量管理部根据《客户投诉管理程序》进行处理。
 - 5.7.3.3. 由质量管理部组织相关人员召开环境管理物质分析会议,进行原因分析,制定整改措施,质管部对其相应对策进行跟踪。
 - 5.7.3.4. 进行整改时,应考虑到本批次所有产品,包括:库存品、在制品、不良品、客户处产品、在运输途中的产品,对这些产品进行追溯。
- 5.8. HS 控制的审核
 - 5.8.1. 供应商、外协厂商的审核
 - 5.8.1.1. 对供应商或外协厂商的审核形式,包括现场审核、信函调查、二方审核。
 - 5.8.1.2. 我公司每年将不定期对供应商提供的零部件或材料中 HS 的含量进行检测,以核对供应商提供数据的可靠性,如检测不合格,按照 5.9 条款给予处罚,



严重的应追究法律责任。

- 5.8.1.3. 对涉及 HS 的供应商、外协厂商应定期（每 1-2 年）进行现场审核或其它方式的审核，审核应留有记录，并提出审核结果报告。
- 5.8.1.4. 各相关部门负责督促有害物质第三方检测报告的更新，并保持有效，安保部每月跟踪采购中心及封装管理部相关资料及报告的更新情况；
 - 5.8.1.4.1. 供应商材料有害物质登记表随时更新，且每年更新一次；
 - 5.8.1.4.2. 供应商环保声明，跟随法律法规和我公司制度的变化，进行更新；
 - 5.8.1.4.3. 合格供应商名单及合格外协厂家名单，随时更新。
- 5.8.1.5. 当出现以下情况时，应立即对供应商进行审核；
 - 5.8.1.5.1. 我公司对原材料抽测结果不合格；
 - 5.8.1.5.2. 客户反馈我公司产品有问题，与之相关联的供应商；
 - 5.8.1.5.3. 供应商的原材料或工艺变动时；
- 5.8.1.6. 审核后，安保部应提出审核意见（即保留、保留须改进、解除商务关系），并将建议传递给原材料供应商或外协厂家；
- 5.8.2. 生产现场环境管理物质控制的审核
生产现场的 HS 审核每年至少进行一次，审核前应制定审核检查表，由 HSF 体系内审员进行。
- 5.9. 环保违规处罚：
 - 5.9.1. 原材料及外协产品违规处罚
 - 5.9.1.1. 我公司对原材料或外协产品进行抽测，如有害物质超过我公司管理标准，但未对我公司造成任何影响，我公司会及时将此信息通报相应的供应商或外协厂家，并将此批次的产品送至共同认可的第三方检测机构进行重新检测，如检测合格，以此合格报告为准。如检测不合格，要求供应商或外协厂家提交原因分析及整改措施，并且，供应商或外协厂商需支付违约金 5—10 万元。
 - 5.9.1.2. 如果客户反馈某种产品环境管理物质超标，我公司会将此信息传递给所有有关供应商或外协厂家，并对相同批次和型号的（从留样中，或从最近的批次进行抽测）原材料或产品进行抽测，如经验证是某供应商或外协厂商的问题，则供应商或外协厂商应承担全部责任和赔偿。
 - 5.9.1.3. 客户反馈或我公司抽测发现有害物质超过欧盟 ROHS 标准，则对此批产品或原材料全部销毁，如对我公司造成影响，供应商或外协厂商应赔偿所有损失，并支付违约金 10 万元。



- 5.9.1.4. 供应商或外协厂商未按照我公司规定的时间提交所要求的 ROHS 资料，或提供虚假资料，未对我公司造成任何影响，视情节需支付违约金 2000 至 10000 元；已经造成影响，赔偿我公司全部损失，并支付违约金 5 万元。
- 5.9.2. 供应商或外协厂商出现以上环保违规情况后，直至在此问题彻底解决前，对其货款进行冻结。
- 5.9.3. 我公司将违约金信息传递给供应商或外协厂商，待其确认后，直接从货款中扣除。违约金确认信息单发出 15 日后（以 EMS 邮寄日期为准），如相关方无信息回馈，即视为接受。

6. 支持文件

- 《供应商管理程序》
- 《封装外包管理程序》
- 《产品监视和测量管理程序》
- 《标识和可追溯性管理程序》
- 《客户投诉管理程序》。
- 《不合格品管理程序》
- 《欧盟关于报废电子电气设备的指令》(WEEE 指令) (2002/96/EC)
- 《欧盟关于包装以及包装废弃物的指令》(94/62/EC)
- 《欧盟关于镉的限制使用的指令》(91/338/EEC)
- 《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(Montreal Protocol)
- 《欧盟关于危险品的分类、包装和标记的指令》(67/548/EEC)
- 《关于某些危险物质和制剂限制销售和使用的指令》(76/769/EEC)
- 《SONY SS-00259 标准》
- 《欧盟法规(EC)No. 1907/2006 有关化学品的注册、评估、授权和限制》(REACH)
- 《欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令》(2011/65/EU) (RoHS2.0 指令)

7. 相关记录

序号	记录名称	记录编号	保管部门	保存期限	机密等级
1	《零/部件或原材料成份展开表》	Q/IGD.H4101-01	技术工程部	3 年	C 级
2	《MATERIAL CONTENT DECLARATION FORM》	Q/IGD.H4101-02	技术工程部	3 年	C 级



华微电子
SINO-MICROELECTRONICS

有害物质控制管理程序

编号: Q/IGD.H4101

版本号: A/9

机密等级: C级

第 16 页共 42 页

3	《有害物质调查表》	Q/IGD.H4101-03	技术工程部	3年	C级
---	-----------	----------------	-------	----	----

8. 附录

附录 1: 《环境管理物质控制承诺书》

附录 2: 我公司对外承诺《环境管理物质控制承诺书》

附录 3: SONY SS-00259 标准